

Винахід стосується способу ґрунтування субстрату, який включає приведення субстрату в контакт з ґрунтовкою, що подається з джерела ґрунтовки, та осадження ґрунтовки на субстрат. В порівнянні з іншими способами ґрунтування, ґрунтування згідно з винаходом приводить до кращих результатів, оскільки осадження проводять електростатично за допомогою електроспінінга.